

D145信息披露

证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2025-078 上海南芯半导体科技股份有限公司 截至2025年9月30日止前次募集资金 使用情况专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、前次募集资金情况

(一)前次募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会于2023年2月21日出具的《关于同意上海南芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]365号),公司获准向社会公开发行股票人民币普通股6,533.00万股,每股发行价格为人民币39.99元,募集资金总额为人民币254,056.47万元,扣除发行费用人民币16,572.76万元(不含税金额),实际募集资金净额为人民币237,483.71万元,上述资金已全部到位。李斌女士(职务为特别授权代表)为公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了核验,并出具了《上海南芯半导体科技股份有限公司验资报告》(容诚验字[2023]23020068号)。

(二)募集资金使用及结余情况

截至2025年9月30日止,公司累计实际投入项目的募集资金款(含置换金额)共计104,267.05万元,累计使用永久补充流动资金75,060.61万元,累计利息收入及理财收益5,432.94万元(扣除银行手续费),募集资金可用余额为63,588.99万元。公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为52,000.00万元,募集资金专户余额合计为11,588.99万元。

(三)前次募集资金在专户中的存放情况

为规范募集资金的管理和使用,公司对募集资金实行专户存储。公司根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《上海南芯半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”),对募集资金专户存储制度、对募集资金的存放、使用等进行了规定。

2023年3月4日,本公司与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、中信银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海农村商业银行股份有限公司上海张江支行、兴业银行股份有限公司上海大柏树支行及深智机构中信建投证券股份有限公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2025年5月9日,本公司、本公司子公司浙江南芯半导体有限公司与招商银行股份有限公司上海分行、上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议与《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。

截至2025年9月30日止,募集资金存储情况如下:

银行名称	银行账号	余额
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121906870310608	2,611.16
招商银行股份有限公司上海分行营业部	97102298310008	7,078.30
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801500005812	438.38
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801500005811	1,441.15
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801500004114	-
中信银行股份有限公司上海分行营业部	811020011501588062	-
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801500004113	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801500004115	已注销
交通银行股份有限公司上海张江分行	31066686501300660624	已注销
招商银行股份有限公司上海分行营业部	1219068703106085	已注销
上海银行股份有限公司浦东科技支行	08005244551	已注销
兴业银行大柏树支行	21636100100071052	已注销
上海农村商业银行张江科技支行	33011000950003329	已注销
合计	—	11,588.99

截至2025年9月30日止,募集资金购入理财余额情况如下:

银行名称	银行账号	余额
招商银行股份有限公司上海分行营业部	121906870310608	3,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801500005812	18,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行	97160078801500005811	25,000.00
招商银行股份有限公司上海分行营业部	97102298310008	6,000.00
合计	—	52,000.00

二、前次募集资金的实际使用情况说明

(一)前次募集资金使用情况对照表

截至2025年9月30日止,前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况说明

2025年2月28日,公司召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目,使用超募资金追加投资额以实施募投项目的议案》,并经2025年3月25日召开的《公司2025年第一次临时股东大会审议通过同意公司拟将募投项目“测试中心建设项目”,变更为“芯片测试”产业园建设项目”,实施主体为浙江南芯半导体有限公司,项目总投资144,250.24万元,分期进行建设,一期投入71,287.30万元,二期投入72,962.94万元。

“测试中心建设项目”变更主要是基于对市场行业发展趋势的判断,为满足公司发展战略的规划,将“测试中心建设项目”变更为“芯片测试”产业园建设项目”,能够为公司采购研发设计提供供应链保障;通过芯片测试研发和生产的一体化,提升公司产品品质和技术能力,能够有效提升产品品质,提高生产效率,降低不良率和售后服务成本,提升公司产品品质管理水平,同时自主可控的测试产线有利于保障公司产品稳定供应,有利于公司产品品质提升,能够提升公司的核心竞争力,支持公司经营规模的提升,尤其是车规业务规模的发展,符合公司长期发展战略。因此,公司将原“测试中心建设项目”,变更为“芯片测试”产业园建设项目”,实际变更募集资金27,323.64万元及其本息1,036.21万元用于“芯片测试”产业园建设项目”,同时使用闲置超募资金29,684.23万元及其本息1,687.01万元追加投资额,合计实际使用募集资金57,007.87万元及其本息5,723.32万元用于“芯片测试”产业园建设项目”一期投资。其余所需资金由公司自有资金、自筹资金补足,变更募集资金金额为57,007.87万元,占募集资金总额的19.4006%。

2025年3月4日,保荐人中信建投证券股份有限公司对上述变更发表核查意见,同意上述事项。

(三)前次募集资金实际投资项目变更的原因及合理性说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容详见本报告附件1。

(四)前次募集资金投资先期投入人自投入及置换情况

公司于2023年6月13日召开了第二届董事会第十六次会议及第一届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付的发行费用的自筹资金。置换预先投入募投项目的自筹资金人民币5,136.55万元,置换已支付的发行费用的自筹资金为人民币567.15万元(不含增值税),合计置换募集资金人民币5,703.70万元。

(五)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至2025年9月30日止,公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(六)前次募集资金使用情况说明

1、闲置募集资金进行现金管理情况

2023年5月25日召开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币12亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构型存款、通知存款、大额存单、协定存款等),使用期限不超过12个月,在前述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。

2024年8月7日召开第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,使用最高不超过人民币10亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构型存款、通知存款、大额存单、协定存款等),使用期限不超过12个月,在前述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。

截至2025年9月30日止,公司使用暂时闲置的募集资金用于现金管理的余额为52,000.00万元。

2、公司尚未使用募集资金情况

截至2025年9月30日止,公司前次募集资金余额237,483.71万元,公司累计投入项目的募集资金款(含置换金额)共计104,267.05万元,累计使用永久补充流动资金75,060.61万元,累计利息收入及理财收益5,432.94万元(扣除银行手续费),募集资金可用余额为63,588.99万元。公司累计使用暂时闲置的募集资金进行现金管理余额为52,000.00万元,募集资金专户余额合计为11,588.99万元。

3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年9月30日止,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

本公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见报告附件2。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“测试中心建设项目”作为公司研发能力提升建设项目,不产生直接的经济效益,但项目实施后能够提升公司的研发能力,建立比较技术壁垒,加速技术创新,实现规模化生产,进一步巩固和提高公司的核心竞争力。

“补充流动资金”和“超募资金永久补充流动资金”项目将进一步优化公司财务状况和现金流状况,为公司主营业务相关的经营活动提供资金支持,提高公司资产运营能力和支付能力,提高公司经营风险管理能力,对公司经营业绩产生积极影响,从而间接提高公司效益。

上述募集资金投资项目均无法单独核算效益,所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

(三)募集资金投资项目累计实现效益低于承诺的效益情况说明

截至2025年9月30日止,本公司未对募投项目的使用效益做出任何承诺,不涉及投资项目的累计实现效益低于承诺的效益情况说明。

四、前次募集资金使用与承诺用途不符的情况说明

截至2025年9月30日止,公司前次募集资金不存在以承诺用途以外的用途使用募集资金的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

截至2025年9月30日止,公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司
董事会
2025年11月27日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表											
截至 2025 年 9 月 30 日											
编制单位：上海南芯半导体科技股份有限公司											
金额单位：人民币万元											
募集资金总额				237,483.71		已累计使用募集资金总额		179,327.66			
变更用途的募集资金总额				77,007.87		本年实际使用募集资金总额				86,557.84	
				2023 年						2024 年	
变更用途的募集资金总额比例				24.00%		2025 年 1-9 月				31,662.75	
投资项目				募集资金投资计划进度				截止日募集资金投资计划进度			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资总额	募集前承诺投资比例	募集后承诺投资比例	实际投资占承诺投资的比例	未达到计划进度原因	项目是否可行	是否达到预计收益
1	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
2	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
3	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
4	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
5	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
6	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
7	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
8	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
9	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
10	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
11	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
12	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
13	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
14	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
15	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
16	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
17	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
18	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
19	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
20	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
21	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
22	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
23	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
24	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
25	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
26	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
27	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
28	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
29	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
30	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
31	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
32	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
33	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
34	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
35	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
36	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
37	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
38	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
39	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
40	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
41	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
42	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
43	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
44	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
45	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
46	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
47	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
48	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
49	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
50	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
51	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
52	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
53	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
54	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
55	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
56	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
57	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
58	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
59	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
60	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
61	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
62	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
63	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
64	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
65	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
66	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
67	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
68	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
69	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
70	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
71	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
72	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
73	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
74	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
75	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
76	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
77	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
78	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
79	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
80	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
81	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
82	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
83	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
84	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
85	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
86	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
87	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
88	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
89	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
90	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
91	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
92	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.45	686.45	63.71	45.06%	45.06%	94.26%	2025 年 12 月		
93	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	高性能低功耗管理和高性能低功耗管理芯片研发和产业化项目	686.								